

半導體工程系 四技 111 學年度入學課程結構規劃表

課程類別	一年級						二年級						三年級						四年級						
	第一學期			第二學期			第一學期			第二學期			第一學期			第二學期			第一學期			第二學期			
	課程名稱	學分數	時數	課程名稱	學分數	時數	課程名稱	學分數	時數	課程名稱	學分數	時數	課程名稱	學分數	時數	課程名稱	學分數	時數	課程名稱	學分數	時數	課程名稱	學分數	時數	
校共同必修課程	應修學分數 12學分	實務應用文	2	2	中文閱讀與表達	2	2	實用英文(三)	2	2	實用英文(四)	2	2												
		實用英文(一)	2	2	實用英文(二)	2	2	實用英文(三)	2	2	實用英文(四)	2	2												
		體育(一)	0	2	體育(二)	0	2	體育(三)	0	2	體育(四)	0	2												
		服務教育(一)	0	2	服務教育(二)	0	2																		
通識課程	應修學分數 6學分 (每領域必修1門)	海洋科技與文明發展	核心(一)海洋科技探索2/2																						
		生命探索與在地關懷	核心(一)海洋文明發展2/2																						
		創意創新與數位知能	核心(二)生命與倫理2/2																						
			核心(二)在地文化探源2/2																						
博雅通識	應修學分數 10學分 (5大課群 至少任選3 課群)	美感與人文素養	博雅通識/學分數/時數																						
		科技與環境永續	博雅通識/學分數/時數																						
		社會與知識經濟	博雅通識/學分數/時數																						
		歷史與多元思維	博雅通識/學分數/時數																						
全球與未來趨勢		博雅通識/學分數/時數																							
跨課群認列		通識微學分(一)1、通識微學分(二)1																							
學院共同課程 (由學院開課)	選修	工程實作實習/3/3																							
學院跨領域課程 (由學院開課)	選修	光：訊號與能源/3/3 機器人程式編程與演算法概念/2/2 虛擬實境互動實務/1/3 3D列印實務/1/3 智慧科技應用專論/3/3 專用電子應用及實務/3/3 機光電半導體封測/3/3																							
必修	應修課程數 20門/ 應修學分數 50學分	電路學(一)	3	3	電路學(二)	3	3	電子學(二)	3	3	電腦輔助電路設計與實驗	1	3	半導體製程與設備	3	3	實務專題(一)	2	4	實務專題(二)	2	4			
		微積分(一)	3	3	微積分(二)	3	3	工程數學(一)	3	3	電磁學(一)	3	3												
		普通物理(一)	3	3	普通物理(二)	3	3	微電子電路實驗	1	3															
		普通物理實驗(一)	1	2	普通物理實驗(二)	1	2	半導體元件(一)	3	3															
		普通化學	3	3	數位邏輯	3	3																		
				電子學(一)	3	3																			
系專業課程	應修學分數 至少 50學分	半導體產業介紹/2/2			向量分析/2/2			感測元件應用電路實習/2/3			電源管理晶片設計與實習/3/3														
		計算機與程式應用/2/3			線性代數/3/3			光電元件量測暨封裝實習/2/3			發光二極體元件及其應用/3/3														
		科技英文/3/3			工程數學(二)/3/3			單晶片實驗/3/3			感測網路應用實務/3/3														
					半導體元件(二)/3/3			半導體設備真空系統實務/3/3			真空技術/3/3														
					光電半導體元件/2/2			Python程式設計與實習/2/3			生物感測/3/3														
					微控制器實習/1/3			射頻電路設計與實習(二)/3/3			磊晶工程/3/3														
					射頻電路設計與實習(一)/3/3			太陽能光電技術/3/3			薄膜技術/3/3														
					嵌入式系統實習/2/3			太陽能電池製程與應用/3/3			自動控制/3/3														
					虛擬圖控儀表實習/2/3			數位訊號處理/3/3			微機電製程/3/3														
					可程式邏輯控制實習/2/3			VLSI電路設計實習(一)/3/3			液晶平面顯示器/3/3														
					電腦網路概論/3/3			VLSI電路設計實習(二)/2/3			類比電路設計/3/3														
					VLSI工具實務/2/2			半導體量測實驗/2/3			訊號與系統/3/3														
					專案實習/3/3			半導體奈米技術/3/3			奈米生醫感測/3/3														
					暑期實習-產業實習/3/3			半導體製程設備實務培訓/3/3			大數據資料庫應用實務/3/3														
								半導體材料科學/3/3			半導體設備/3/3														
								半導體負電阻元件/3/3			半導體評估技術/3/3														
								半導體無塵室技術/3/3			半導體構裝材料與製程簡介/3/3														
								半導體設備基礎技能實務/3/3			半導體元件製程與特性模擬/3/3														
								半導體設備元件儀控系統實務/3/3			產業問題導向學習/3/3														
								半導體元件製程與特性模擬/3/3			產業實務見習與總結/1/1														
						半導體產業技術問題與實習導向/3/3			半導體產業技術問題與實習導向/3/3																
						半導體產業實務見習與總結微學分/1/1			半導體產業實務見習與總結微學分/1/1																
						電磁學(二)/3/3			專案實習/3/3																
						複變函數/3/3			暑期實習-產業實習/3/3																
						機率/3/3			學期實習-產業實習(一)/9/9																
						專案實習/3/3			學期實習-產業實習(二)/9/9																
						暑期實習-產業實習/3/3																			
						學期實習-產業實習(一)/9/9																			
						學期實習-產業實習(二)/9/9																			

(接續背面)

備註：

一、畢業總學分數為 128 學分。

二、必修 50 學分，選修 50 學分。(不含校共同必修課程及通識課程的學分數)

三、校共同必修課程及通識課程 28 學分；相關規定依據本校「共同教育課程實施辦法」、「共同教育課程結構規劃表」及「語言教學實施要點」。

四、須修滿英(外)語 8 學分，本國籍學生英語畢業門檻為等同 CEFR B1 以上程度之各類英檢成績。在學期間參加 2 次各類英檢考試，未通過者，須提出考試成績證明始得以下列其中一種方式通過：1.通過校內英語畢業門檻檢定考試。2.參加一期外語教育中心開設之短期英文加強課程，並符合課程簡章規定。3.修讀並通過就讀院系開設 2 學分以上全英授課專業課程 1 門。多益成績達 550 分(或等同 CEFR B1 等級)以上者得免修大一英語(4 學分);多益成績達 785 分(或等同 CEFR B2 等級)以上者得免修大一、大二英語(8 學分)，但須選修主題式英語或其他外語課程補足語言畢業學分數。其他外語課程請參閱外語教育中心課程結構規劃表。

五、學生修讀所屬學院之「學院共同課程」應認列為本系專業課程學分；修讀所屬學院之「學院跨領域課程」或其他學院開課之課程，則認列為外系課程學分。

六、系所訂定條件(學程、檢定、證照、承認外系學分及其他)：

1.於就學期間，需通過相關專業檢定(證照之張數及類別如下：一張電機、電子類相關證照或二張資訊類相關證照)，附有證明文件，經審查合格，始得畢業。

2.「計算機與程式應用」、「半導體產業介紹」、「向量分析」、「光電半導體元件」課程為必修科目。

3.承認外系(非通識)選修學分至多 12 學分為專業選修，其中非本院開設之專業選修課程至多承認 6 學分。



114. 3. 18